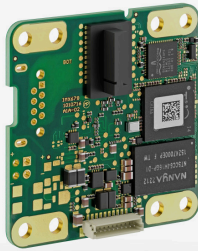
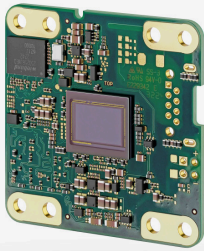


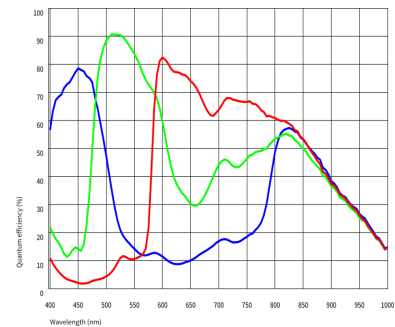
■ 양산 단계
이 모델은 양산 단계에 있으며 장기간 구매 및 사용이 가능합니다.



사양

센서

센서 타입	CMOS 컬러
셔터	Rolling shutter
센서 특성	선형의
픽셀 등급	13 MP
해상도	12.62 Mpix
해상도 (h x v)	3552 x 3552 픽셀
종횡비	1:1
ADC	12 bit
색 심도(카메라)	12 bit
광학 센서 등급	1/1.6"
광학 영역	7.104 mm x 7.104 mm
광학 센서 대각선	10.05 mm 1/1.6"
픽셀 크기	2 μ m
CRA (주광선 각도)	12 °
제조사	Sony
센서 모델	IMX676-AACR1-C
게인(마스터/RGB)	31.6x/16x
AOI 수평	동일한 프레임 레이트
AOI 수직	프레임 레이트 증가
AOI 이미지 너비/단차 너비	256 / 2
AOI 이미지 높이/단차폭	2 / 2
AOI 위치 그리드(수평/수직)	2 / 2
수평 비닝	프레임 레이트 증가
수직 비닝	프레임 레이트 증가
비닝 방법	수평: 평균 / 수직: 평균
비닝 요소	2x2
수평 decimation (서브샘플링)	-
수직 decimation (서브샘플링)	-
decimation (서브샘플링) 방법	M/C 자동



모델

프레임 레이트 프리런 모드	9.9 fps
프레임 레이트 트리거(연속)	9.9 fps
프레임 레이트 트리거(최대)	14 fps
노출 시간(최소 - 최대)	0.037 ms - 1999 ms
긴 노출(최대)	119977 ms
전력 소비	2.5 W - 4 W
이미지 메모리	128 MB

HDR

모드	ClearHDR
----	----------

주변 조건들

PCB 버전들의 경우, 각각의 문서 내의 별도 힌트들을 참조하십시오.

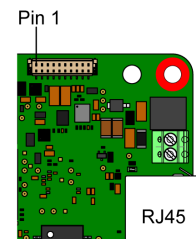
작동 중 허용되는 장치 온도	0 °C - 90 °C / 32 °F - 194 °F
작동 중 허용되는 주변 온도	0 °C - 40 °C / 32 °F - 104 °F
보관 중 허용되는 주변 온도	-20 °C - 60 °C / -4 °F - 140 °F
습도(상대, 비응축)	20 % - 80 %

커넥터들

인터페이스 커넥터	ZIF
I/O 커넥터	10-핀 Wuerth 커넥터 (WR-WTB 1.00 mm)
전력 공급	12 V - 24 V

핀 할당 I/O 커넥터

1	전력 공급 장치 (VCC) 12-24V
2	전력 공급 장치, 접지
3	범용 I/O (GPIO) 2, 3.3 V - Line 3
4	범용 I/O (GPIO) 1, 3.3 V - Line 2
5	I2C SCL (signal clock) 3.3 V
6	I2C SDA (signal data) 3.3 V
7	옵토커플러 없이 트리거 입력 3.3 V - Line 0
8	옵토커플러 없이 플래시 출력 3.3 V - Line 1
9	접지 (GND)
10	전압 출력 3.3 V, 최대 100 mA



디자인

렌즈 마운트	No mount
IP 코드	-
치수 H/W/L	45.0 mm x 45.0 mm x 10.0 mm
무게	12 g
하우징 자재	-

Features

카메라 내 이미지 사전 처리 기능 목록입니다.

표의 모든 기능은 호스트 컴퓨터에서 이미지 전처리를 위한 IDS peak 소프트웨어를 통해 사용할 수 있습니다(센서 모델에 따라 다름).

GV-54L2LE-C-MB Rev.2 (1011631)

이미지 획득

Freerun	✓
Software trigger	✓
Hardware trigger	✓
Trigger controlled exposure	-
Denoiser	✓
Long exposure	✓
Line scan	-
Global start	-

깜박임

Flashing	-
PWM flashing	-

이미지 조정

Auto exposure	-
Auto gain	-
Auto whitebalance	-
Color correction	-
Gamma	-
LUT	-
Mirror/flip	X/Y

온보드 이미지 처리

Pixel formats	BayerRG8 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BayerRG10
Region of interest	✓
Decimation (FPGA)	✓
Decimation (Sensor)	-
Binning (FPGA)	-
Binning (Sensor)	2x2 Increases frame rate.

기타

IP settings	✓
Bandwidth management	✓
Chunks	-
Sequencer	-
PTP	✓
Firmware update	✓
1st supported firmware version	3.60